

## 电子行业周报（8.26-9.01）

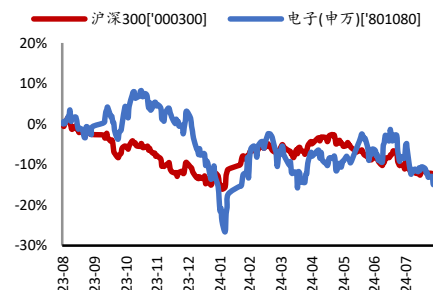
### 关注 9 月 10 日苹果秋季发布会

#### 投资要点：

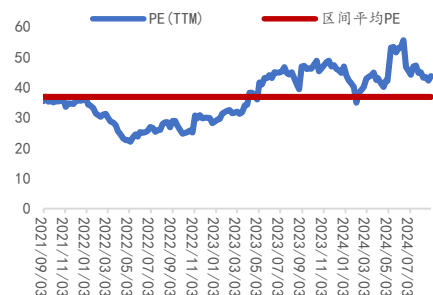
- **苹果9月新品发布会备受瞩目，从供应商备货以及面板出货看新机销量预期向上。**苹果公司宣布计划于太平洋时间9月9日上午10点（北京时间9月10日凌晨1点）在加州总部举行新品发表会，主题为“It's Glowtime（高光时刻）”，将发布iPhone 16系列（包含16、16 Plus、16 Pro以及16 Pro Max四款机型）以及新一代AirPods和Apple Watch。iPhone 16系列手机右侧新增拍照及操作按钮，Pro/Pro Max型号配备6.3/6.9英寸大屏，比上一代增加0.2英寸；AirPods 4将推出两个新版本，并且首次在中级版本上提供降噪功能；Apple Watch Series 10型号将更薄但荧幕更大。苹果已告知供应商为大约8800万~9000万部智能手机备货零部件，这比去年8000万部新iPhone的初始零部件订单有所增长。同时，iPhone 16系列的面板已于今年7月开始出货，出货量相较2023年6月和7月的iPhone 15系列高出20%。从供应商备货以及面板出货看新机销量预期向上。
- **iPhone 16系列作为苹果AI功能预热机型，有望引领智能硬件更新换代潮流。**苹果早在今年6月的年度开发者大会上宣布其AI策略，将新系统“Apple Intelligence”技术整合至旗下的应用中，包括Siri，并将引入ChatGPT。iOS 18预期将在新品发布一周后推出，目前已更新至第8个测试版Beta 8，届时将引入Apple Intelligence的全新AI功能。iPhone 16系列将标配新的A18系列芯片，采用更大的芯片尺寸，同时升级8GB内存，为将来Apple Intelligence的高算力运行提供支持。AI助力全球智能硬件更新换代，iPhone 16系列作为苹果AI功能预热机型，有望引领潮流，实现销量及市占率的提升。
- **AI驱动智能硬件升级，带动量价齐升。**AI功能将带来智能硬件中的处理器、存储、电池、快充、散热等部件的升级，带来整体价值量的提升。同时AI功能也将带来更加丰富的应用落地，刺激更新换代需求，带来出货量增长。短期看消费电子需求回暖，叠加中长期的AI驱动换机需求量增长及BOM成本增加，两者共振下消费电子有望迎来新的周期，当前时点应重视果链相关投资机会。
- **投资建议：**建议关注消费电子产业链相关公司，如立讯精密、恒铭达、领益智造、东山精密、鹏鼎控股、德赛电池、珠海冠宇、蓝思科技、歌尔股份、赛腾股份等。
- **风险提示：**技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险；行业景气不及预期。

### 强于大市（维持评级）

#### 一年内行业相对大盘走势



#### 电子行业估值（PE）



#### 团队成员

分析师 杨钟  
执业证书编号：S0210522110003  
邮箱：yz3979@hfzq.com.cn

分析师 钟俊杰  
执业证书编号：S0210524080002  
邮箱：zj3909@hfzq.com.cn

联系人 詹小璁  
邮箱：zxm30169@hfzq.com.cn

#### 相关报告

- 《关注〈黑神话：悟空〉对 AI PC 及高清显示行业的带动》——2024.08.25
- 《关注折叠屏手机形态演进及新机发布》——2024.08.18
- 《关注晶圆载具国产化替代》——2024.08.11

## 正文目录

|     |                                                  |    |
|-----|--------------------------------------------------|----|
| 一、  | 本周市场表现.....                                      | 3  |
| 1.1 | 电子板块本周表现.....                                    | 3  |
| 1.2 | SW 电子个股本周表现 .....                                | 3  |
| 1.3 | 电子板块估值分析.....                                    | 4  |
| 二、  | 行业动态跟踪.....                                      | 6  |
| 2.1 | 半导体板块.....                                       | 6  |
| 1)  | 7 月全球半导体并购事件 285 起，环比增加 18%，平均交易金额环比增加 39% ..... | 6  |
| 2)  | 三星 2025 年量产 2nm 芯片：使用背面供电技术，芯片尺寸缩小 17% .....     | 6  |
| 3)  | 机构：2024 年先进封装设备销售额将增长 10%以上 .....                | 7  |
| 4)  | SK 海力士成功开发出全球首款第六代 10 纳米级 DDR5 DRAM.....         | 7  |
| 5)  | 曝台积电明年量产 2nm：苹果又将拿到首发权.....                      | 8  |
| 6)  | 中芯国际 2024 年上半年营收 262.69 亿元 同比增长 23.2%.....       | 9  |
| 2.2 | 消费电子板块.....                                      | 9  |
| 1)  | 机构：折叠屏手机推动，2025 年中高端背板技术渗透率达 60%.....            | 9  |
| 2)  | 传小米计划明年推出三折叠屏手机 .....                            | 10 |
| 3)  | 中国信通院：7 月国内智能手机出货量 2217.4 万部，同比增长 28.3%.....     | 10 |
| 4)  | 宏碁：计划明年将 AI PC 出货量提升至 40%.....                   | 11 |
| 三、  | 公司动态跟踪.....                                      | 11 |
| 四、  | 风险提示.....                                        | 12 |

## 图表目录

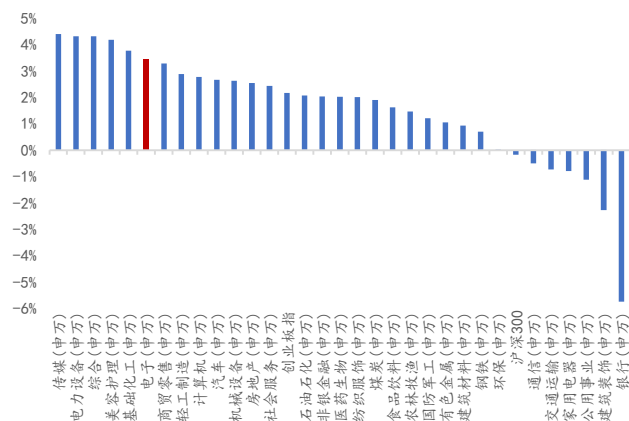
|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 图表 1：SW 各行业板块本周市场表现.....          | 3  |
| 图表 2：电子板块成交额及日涨跌幅.....            | 3  |
| 图表 3：电子细分领域本周涨跌幅（%） .....         | 3  |
| 图表 4：SW 电子本周涨幅前十个股（%） .....       | 4  |
| 图表 5：SW 电子本周跌幅前十个股（%） .....       | 4  |
| 图表 6：SW 电子本周换手率前二十个股（%） .....     | 4  |
| 图表 7：SW 电子行业指数 PE 走势（TTM） .....   | 5  |
| 图表 8：SW 电子细分行业指数 PE 走势（TTM） ..... | 5  |
| 图表 9：过去一周股东增减持更新 .....            | 11 |
| 图表 10：过去一周股权激励一览.....             | 12 |

## 一、 本周市场表现

### 1.1 电子板块本周表现

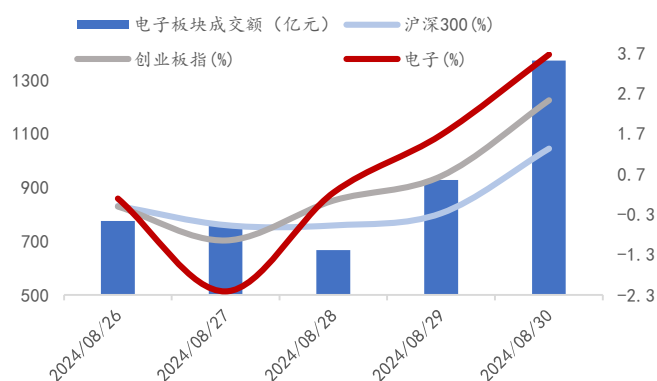
大盘表现上，本周（0826-0901）创业板指数上涨 2.17%，沪深 300 指数下跌 0.17%。本周电子行业指数上涨 3.43%。行业表现上，电子行业涨跌幅位列全行业的第 6 位，本周传媒、电力设备、综合板块涨跌幅位居前列。

图表 1：SW 各行业板块本周市场表现



数据来源：Wind，华福证券研究所

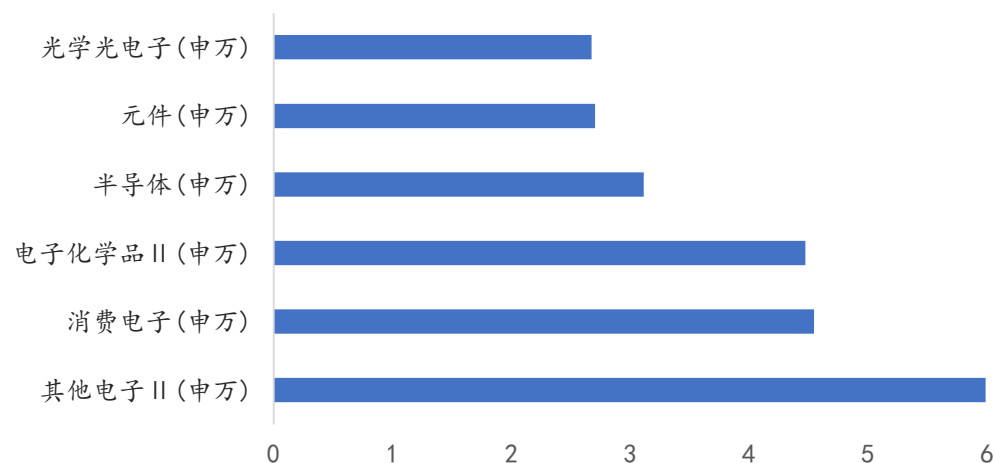
图表 2：电子板块成交额及日涨跌幅



数据来源：Wind，华福证券研究所

从电子细分行业指数看，本周电子细分板块均呈上涨态势，具体来看，其他电子板块领涨，周涨跌幅为+5.99%；光学光电子板块涨幅最小，周涨跌幅为+2.67%。

图表 3：电子细分领域本周涨跌幅 (%)

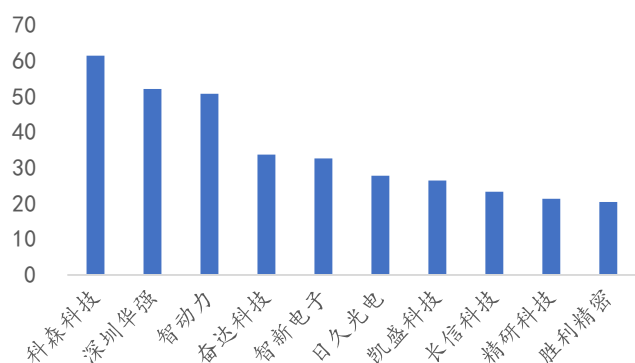


数据来源：Wind，华福证券研究所

### 1.2 SW 电子个股本周表现

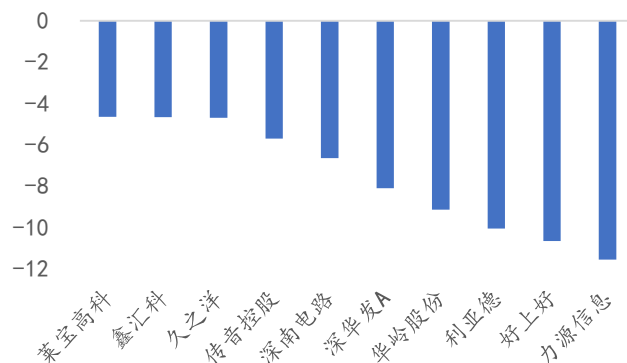
从个股维度来看，SW 电子板块中，科森科技 (61.30%)、深圳华强 (52.03%) 等位列涨幅前列；力源信息 (-11.56%)、好上好 (-10.67%) 等位列跌幅前列。

图表 4：SW 电子本周涨幅前十个股（%）



数据来源：Wind，华福证券研究所

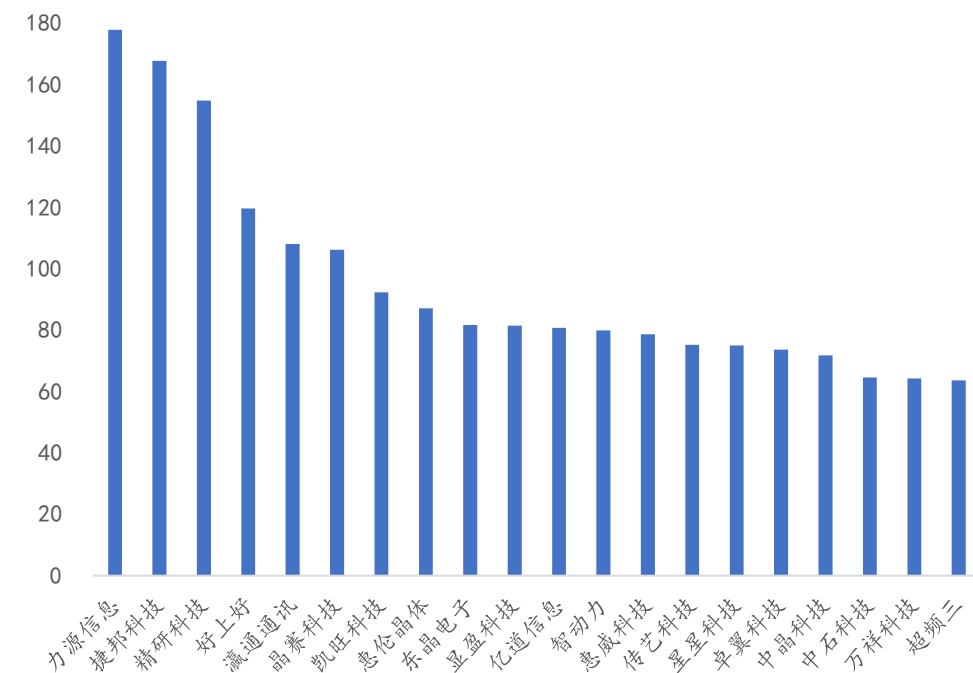
图表 5：SW 电子本周跌幅前十个股（%）



数据来源：Wind，华福证券研究所

从换手率来看,本周电子行业个股换手率最高的是力源信息,换手率为 177.78%。其余换手率较高的还有捷邦科技（167.62%）、精研科技（154.73%）、好上好（119.53%）。

图表 6：SW 电子本周换手率前二十个股（%）



数据来源：Wind，华福证券研究所

### 1.3 电子板块估值分析

从本周PE走势来看,整体电子行业估值低于近一年平均值水平,但高于近三年、五年平均值水平。本周 PE（TTM）为 43.61 倍，较上周有所上调。

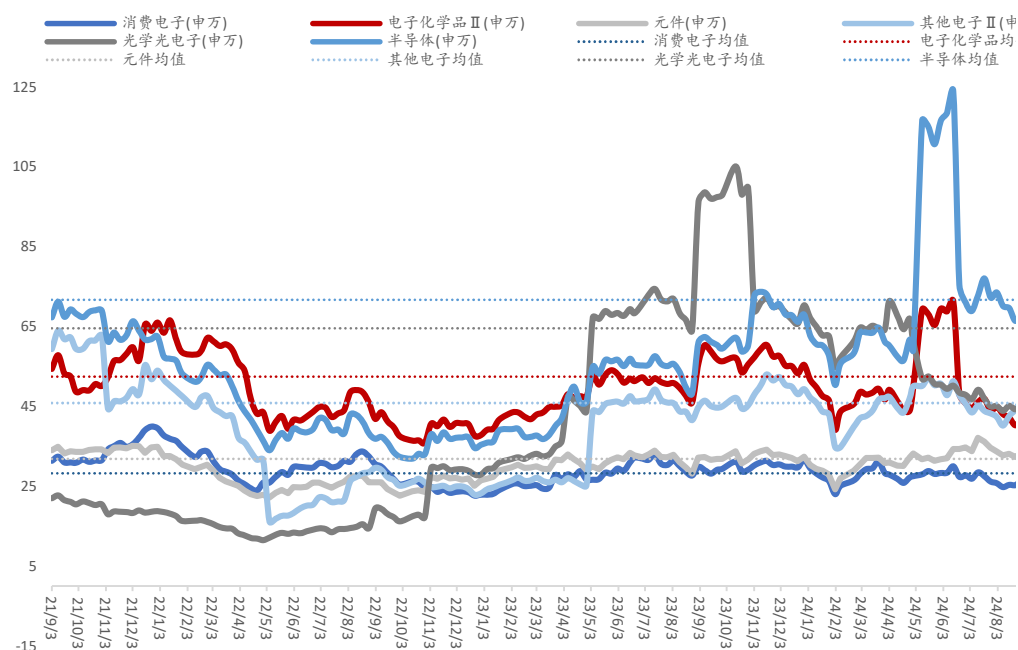
图表 7: SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

细分领域上, 本周消费电子、电子化学品、元件、其他电子、光学光电子和半导体板块 PE 分别为 26.46、42.04、33.22、46.93、45.46 和 68.53, 本周电子细分板块估值均有一定程度上涨。

图表 8: SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

## 二、行业动态跟踪

### 2.1 半导体板块

#### 1) 7月全球半导体并购事件 285 起，环比增加 18%，平均交易金额环比增加 39%

过去几年里，全球半导体产业经历了一段漫长的下行周期。尽管半导体市场表现低迷，但作为长周期内极具成长性的赛道，半导体行业的投资热情并未消失，半导体企业间的并购也从未停止。集微网搜集整理全球半导体行业并购事件，分析半导体行业并购趋势，发布《全球半导体并购报告（2024 年 7 月）》。

据集微咨询统计，2024 年 7 月，全球共发生超 285 起半导体企业并购事件（包括传闻和撤回），环比增加 43 起（18%），同比增加 137 起（93%）。本月并购数量环比上升，同比大幅增长。

按所处交易阶段划分，宣布阶段 64 起，完成阶段 109 起，假设完成阶段 76 起，待定阶段 10 起，传闻阶段 20 起，撤回了 6 起。

按所处国家或地区划分，中国大陆有 78 起，为数最多，日韩地区 42 起，中国台湾 5 起，亚洲其他地区共 19 起，美国 44 起，欧洲地区 70 起，其他地区有 27 起。

2024 年 7 月，有 156 起并购事件披露了标的金额，总额近 268 亿美元，平均交易金额 1.72 亿美元，平均交易金额环比增加 39%。其中，超过 10 亿美元的有 6 起，1~10 亿美元有 21 起，千万~1 亿美元有 60 起，低于千万美元的有 69 起。近十二个月平均交易金额 1.79 亿美元(中位数)。（资料来源：集微网）

#### 2) 三星 2025 年量产 2nm 芯片：使用背面供电技术，芯片尺寸缩小 17%

近日有消息称，三星代工厂预计将于明年开始使用其第一代 2nm 工艺节点生产芯片，该节点将使 EUV 层的数量增加 30%至 26 层。

ASML 是全球唯一能够生产极紫外(EUV)光刻机的荷兰企业。EUV 使用极细的线条将电路图案蚀刻到硅片上，以帮助放置芯片内的元件。智能手机中使用的处理器需要多层。

三星代工厂目前在 3nm 生产中使用 20 个 EUV 层，如果增加 30%，其 2nm 芯片将使用 26 个 EUV 层。更多的 EUV 层会在芯片内部容纳更多的晶体管，从而使 SoC 能够处理更复杂的任务，同时消耗更少的电量。三星的 2nm 芯片将比当前一代芯片尺寸缩小 17%，功能强大 18%，效率提高 15%。

除了使用更多 EUV 层之外，三星代工厂还将在 2nm 上使用背面供电技术(BSPDN)。这项技术通过将电源线移至芯片背面而非正面，使芯片尺寸减小 17%。这减少了电压降，因为有了更多空间，线路可以做得更大。英特尔也在其 PowerVia 功能中使用了这项技术，它使芯片更强大、更高效。

展望 2027 年，三星代工厂预计将开始使用其 1.4nm 节点进行生产，届时 EUV 层的数量预计将增加到 30 层以上。晶体管数量将再次增加，应用处理器将比现在更强大、更节能。三星代工厂的主要竞争对手是台积电，这家代工厂目前在其 3nm (N3x) 生产中使用多达 25 个 EUV 层。

三星代工厂于 2018 年开始采用 EUV 光刻技术，当时它从 10nm 转向 7nm。在 EUV 光刻技术出现之前，业界使用的是 DUV (深紫外) 光刻技术。三星代工厂还在使用 EUV 进行 DRAM 生产，其第六代 10nm DRAM 芯片的制造使用了 7 层 EUV。另一家 DRAM 设计者和制造商 SK 海力士使用了 5 层 EUV。

与三星代工厂一样，台积电将于明年开始生产 2nm 芯片，其 1.4nm 节点预计将在 2027~2028 年投入生产。(资料来源：集微网)

### 3) 机构：2024 年先进封装设备销售额将增长 10%以上

市场调查机构 TrendForce (集邦咨询) 数据显示，先进封装设备销售额预计在 2024 年增长 10% 以上，2025 年有望超过 20%。这一增长主要得益于主要半导体制造商不断扩大先进封装产能，以及全球人工智能 (AI) 服务器市场的快速扩张。

集邦咨询指出，AI 服务器需求的不断增长推动了包括 InFO、CoWoS 和 SoIC 在内的多种尖端封装技术的进步，世界各地都在建立新的创新封装设施。例如，台积电正在中国台湾竹南、台中、嘉义和台南等地区增加其先进封装产能；英特尔在美国新墨西哥州以及马来西亚居林和檳城建立了业务；三星、SK 海力士和美光等主要存储供应商正在美国、韩国、中国台湾和新加坡建设新的 HBM 封装设施。

先进封装设施的建设也促进了相关设备的销售。先进封装设备包括电镀机、固晶机、熔胶机、减薄机、植球机、切割机、固化机、打标机等设备。先进封装设备供应链的准入门槛较低，台积电等领先晶圆代工厂正策略性地培育本地供应商，以降低成本。

集邦咨询认为，对于中国台湾相关设备制造商而言，能否随着先进封装设备市场的增长而扩大产能，对于其业务增长至关重要。随着主要半导体制造商继续提高先进封装产能，中国台湾封装设备公司除了与顶级代工厂和 OSAT (外包半导体封装和测试) 合作外，还将有机会拓展海外市场。(资料来源：集微网)

### 4) SK 海力士成功开发出全球首款第六代 10 纳米级 DDR5 DRAM

2024 年 8 月 29 日，SK 海力士宣布，全球首次成功开发出采用第六代 10 纳米级 (1c) 工艺的 16Gb (Gigabit, 千兆比特) DDR5 DRAM。由此，公司向世界展现了 10 纳米出头的超微细化存储工艺技术。

SK 海力士强调：“随着 10 纳米级 DRAM 技术的世代相传，微细工艺的难度也随之加大，但公司以通过业界最高性能得到认可的第五代 (1b) 技术力为基础，提高了

设计完成度，率先突破了技术极限。公司将在年内完成 1c DDR5 DRAM 的量产准备，从明年开始供应产品，引领半导体存储器市场发展。”

公司以 1b DRAM 平台扩展的方式开发了 1c 工艺。SK 海力士技术团队认为，由此不仅可以减少工艺高度化过程中可能发生的尝试错误，还可以最有效地将业界内以最高性能 DRAM 受到认可的 SK 海力士 1b 工艺优势转移到 1c 工艺。

而且，SK 海力士在部分 EUV 工艺中开发并适用了新材料，也在整个工艺中针对 EUV 适用工艺进行了优化，由此确保了成本竞争力。与此同时，在 1c 工艺上也进行了设计技术革新，与前一代 1b 工艺相比，其生产率提高了 30% 以上。

此次 1c DDR5 DRAM 将主要用于高性能数据中心，其运行速度为 8Gbps（每秒 8 千兆比特），与前一代相比速度提高了 11%。另外，能效也提高了 9% 以上。随着 AI 时代的到来，数据中心的耗电量在继续增加，如果运营云服务的全球客户将 SK 海力士 1c DRAM 采用到数据中心，公司预测其电费最高能减少 30%。

SK 海力士 DRAM 开发担当副社长金锺煥表示：“1c 工艺技术兼备着最高性能和成本竞争力，公司将其应用于新一代 HBM\*、LPDDR6\*、GDDR7\* 等最先进 DRAM 主力产品群，由此为客户提供差别化的价值。今后公司也将坚守 DRAM 市场的领导力，巩固最受客户信赖的 AI 用存储器解决方案企业的地位。”（资料来源：集微网）

## 5) 曝台积电明年量产 2nm：苹果又将拿到首发权

8 月 30 日消息，据媒体报道，台积电计划于 9 月启动新一轮 CyberShuttle 服务。

所谓 CyberShuttle，中文名为“晶圆共乘”，台积电将不同客户的芯片放在同一晶圆上测试，共同分担光罩的成本，并在短时间内完成芯片试产和验证，强化客户的成本优势和经营效率。

按照惯例，客户每年有两次提交项目的机会，分别在 3 月和 9 月，这次台积电推出的 CyberShuttle 服务亮点是 2nm 工艺节点。

据悉，台积电 2nm 工艺制程进展顺利，新工艺将于明年在新竹宝山工厂开始量产，由苹果首发。

值得注意的是，iPhone 17 系列虽然也是明年亮相，但新机赶不上台积电 2nm 工艺，因此 iPhone 18 系列会成为第一款搭载 2nm 芯片的智能手机。

根据台积电的介绍，与 N3E 节点相比，N2 工艺在相同功耗下的性能提升了 10% 到 15%，在相同性能下功耗降低了 25% 到 30%。

除此之外，台积电 2nm 工艺引入了全新的 SoIC（System on Integrated Chips）封装技术，它能够将多个芯片垂直堆叠在一起，通过硅通孔（TSV）实现高效的电气互连，形成紧密的三维结构。这种新技术不仅能够大幅提升芯片的集成度和功能密度，还能显著降低系统的功耗和延迟。（资料来源：TechWeb）

## 6) 中芯国际 2024 年上半年营收 262.69 亿元 同比增长 23.2%

中芯国际刚刚发布了最新的 2024 半年报，主要财务数据如下：

营业收入为 262.69 亿元，同比增长 23.2%。

归属于上市公司股东的净利润为 16.46 亿元，同比下降 45.1%。

基本每股收益 0.21 元/股，同比下降 44.7%。

毛利 36.53 亿元，同比下降 23.6%。

毛利率 13.8%同比减少 6.8 个百分点，净利率 6.5%同比减少 17.7 个百分点。

研发投入 26.2 亿元同比增长 9.1%，占营业收入 10.1%同比减少 1.3 个百分点。

研发人员 2,300 人，相比去年同期的 2,283 人有所增加；研发人员数量占比 12.2%；研发人员薪酬合计 4.85 亿元，平均薪酬 21.1 万元相比去年同期的 18.3 万元有所上升。

今年上半年，中芯国际中国区收入从去年的 77.6%增长到了 80.9%，美国区收入从 18.6%下降到了 15.5%；智能手机代工收入占比从 25.2%增长到了 31.5%。（资料来源：TechWeb）

## 2.2 消费电子板块

### 1) 机构：折叠屏手机推动，2025 年中高端背板技术渗透率达 60%

市调机构 TrendForce（集邦咨询）的最新调查显示，OLED 已成为智能手机主流显示方案，带动 LTPS（低温多晶硅）、LTPO（低温多晶氧化物）等中高端背板技术在智能手机市场的渗透率在 2024 年接近 57%，预估 2025 年渗透率将挑战 60%。

TrendForce 指出，显示屏背板技术不仅影响屏幕画质，还决定着手机的性能、能耗、成本。自苹果推出 Retina 显示屏以来，业界一直推动 LTPS 背板的发展，以实现更高的屏幕分辨率。

LTPS 具有较高的电子迁移率，可以提供更快的切换速度和更高的分辨率，非常适合高端智能手机。然而，其较高的电子迁移率也导致漏电流较大，无法支持低频动态刷新调整，导致整体功耗较高。

TrendForce 称，目前大多数旗舰智能手机都采用 LTPO 背板。在较大的可折叠手机中，LTPO 可实现具有不同刷新率的分屏功能，从而平衡多任务处理能力和能源效率。

LTPO 在 LTPS 的基础上添加了氧化物半导体，以优化显示性能，包括减少驱动显

示器时的漏电流和根据内容调整屏幕的刷新率。然而，生产 LTP0 背板需要堆叠更多层，因此比 LTPS 更复杂，制造成本也更高。

TrendForce 表示，随着生产规模扩大，LTP0 和氧化物等高端背板的制造成本有望下降。这将使采用这些技术的中尺寸 AMOLED 显示器更具竞争力地渗透到各个产品领域，最终扩大其在不同产品中的市场份额。（资料来源：集微网）

## 2) 传小米计划明年推出三折叠屏手机

可折叠手机行业竞争日益激烈，各公司在这一领域不断努力追求竞争和创新。根据此前报道，三星正在研发双折叠和可卷曲手机，可能会在明年推出。

现在小米正因开发一种三折叠设计而受到关注，这可能会进一步加剧行业竞争。尽管三星是折叠手机概念的先驱，但其他公司也在努力推动该领域的创新。随着最近小米有关正在开发三折叠设计的消息曝光，我们可能会看到市场格局发生巨大变化。

根据微博爆料人 Smart Pikachu 的消息，小米正处于开发的高级阶段，如果这一说法属实，很可能很快就会推出。我们甚至可能会在 2025 年的 MWC 或其他重大活动上看到它的发布，因为到那时设备可能已经准备就绪。鉴于没有更多细节来进一步支持这一说法，我们应该持保留态度。

小米已经进入了可折叠手机行业，因此尽管它可能不会将该类别标记为新鲜事物，但随着竞争的加剧，小米推出的三折叠智能手机可能会在该行业引起变革。有传言称小米手机将搭载澎湃 OS 软件和莱卡相机布局，并在小米的 MIX 品牌下推出，但这仍有待官方确认。（资料来源：集微网）

## 3) 中国信通院：7 月国内智能手机出货量 2217.4 万部，同比增长 28.3%

中国信通院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024 年 7 月，国内市场手机出货量 2420.4 万部，同比增长 30.5%，其中 5G 手机 2065.4 万部，同比增 37.2%，占同期手机出货量的 85.3%。

报告显示，2024 年 1-7 月，国内市场手机出货量 1.71 亿部，同比增长 15.3%；其中 5G 手机 1.45 亿部，同比增长 23.6%，占同期手机出货量的 84.8%；2024 年 7 月，国内手机上市新机型 29 款，同比下降 17.1%，其中 5G 手机 13 款，同比下降 27.8%，占同期手机上市新机型数量的 44.8%。

在上市新机型方面，2024 年 7 月，国内手机上市新机型 29 款，同比下降 17.1%，其中 5G 手机 13 款，同比下降 27.8%，占同期手机上市新机型数量的 44.8%；2024 年 1-7 月，国内手机上市新机型 234 款，同比下降 1.7%，其中 5G 手机 122 款，同比增长 18.4%，占同期手机上市新机型数量的 52.1%。

在手机品牌方面，2024 年 7 月，国产品牌手机出货量 2182.7 万部，同比增长 34.4%，占同期手机出货量的 90.2%；上市新机型 28 款，同比下降 6.7%，占同期手机

上市新机型数量的 96.6%；2024 年 1-7 月，国产品牌手机出货量 1.45 亿部，同比增长 19.9%，占同期手机出货量的 84.8%；上市新机型 220 款，同比增长 0.5%，占同期手机上市新机型数量的 94.0%。

在智能手机出货量方面，2024 年 7 月，国内智能手机出货量 2217.4 万部，同比增长 28.3%，占同期手机出货量的 91.6%；智能手机上市新机型 18 款，同比下降 35.7%，占同期手机上市新机型数量的 62.1%；2024 年 1-7 月，智能手机出货量 1.61 亿部，同比增长 13.7%，占同期手机出货量的 94.2%；智能手机上市新机型 167 款，同比下降 16.9%，占同期手机上市新机型数量的 71.4%。（资料来源：集微网）

4) 宏碁：计划明年将 AI PC 出货量提升至 40%

个人电脑制造商宏碁（Acer）董事长兼 CEO 陈俊圣 (Jason Chen) 近日表示，宏碁计划大幅增加配备人工智能（AI）功能的电脑的出货量。到 2025 年第三季度，宏碁将把 Copilot+ PC 在交付量中的份额提高到 40%。

这些 AI PC 可以生成图像，并执行在线会议的实时字幕翻译，以及其他任务。与其他需要连接到处理服务器的生成式 AI 平台不同，这些设备可以在内部和离线时执行这些功能。

联想集团和惠普等主要竞争对手也在关注 Copilot+ PC 的销售。宏碁的与众不同之处在于，它增加了一个专有的键盘按钮，用于优化声音和其他设置。笔记本电脑的触摸板上有一个活动指示灯，每当使用 AI 芯片时就会亮起。

宏碁的 Copilot+PC 本月在日本上市，售价约为 26 万日元(合 1800 美元)。截至目前，这类设备仅占宏碁总出货量的 1%~2%。该公司将首先增加面向企业的出货量，目标是在一年后将整体出货量份额提高到 40%。

根据 Canalys 的最新数据，2024 年第二季度，AI PC 出货量达 880 万台，占本季度所有 PC 出货量的 14%。

Canalys 指出，随着所有主要处理器供应商的 AI PC 路线图顺利推进，2024 年下半年及以后，设备可用性和最终用户采用率将大幅提升。（资料来源：爱集微）

三、 公司动态跟踪

图表 9：过去一周股东增减持更新

| 证券代码      | 证券简称 | 公告日期       | 方向 | 股东名称 | 股东身份      | 拟变动数量上限      | 拟变动数量<br>上限占总股<br>本比 (%) |
|-----------|------|------------|----|------|-----------|--------------|--------------------------|
| 300736.SZ | 百邦科技 | 2024-08-28 | 减持 | 邓芳   | 持股 5%以上股东 | 3,795,249.00 | 2.92                     |

|           |      |            |    |                                                                                                                                                                                                              |            |              |      |
|-----------|------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|
| 688150.SH | 莱特光电 | 2024-08-28 | 减持 | 北京君联成业股权投资合伙企业, 北京君联慧诚股权投资合伙企业                                                                                                                                                                               | 5%以上非第一大股东 | 8,048,750.00 | 2.00 |
| 002655.SZ | 共达电声 | 2024-08-30 | 增持 | 无锡韦感半导体有限公司                                                                                                                                                                                                  | 控股股东       |              |      |
| 001298.SZ | 好上好  | 2024-08-28 | 减持 | 深圳市聚焦投资管理中心                                                                                                                                                                                                  | 持股5%以上股东   | 1,085,798.00 | 0.53 |
| 001298.SZ | 好上好  | 2024-08-28 | 减持 | 深圳市前哨投资管理中心                                                                                                                                                                                                  | 持股5%以上股东   | 921,904.00   | 0.45 |
| 001298.SZ | 好上好  | 2024-08-28 | 减持 | 深圳市特恒创业投资合伙企业                                                                                                                                                                                                | 特定股东       | 1,065,312.00 | 0.52 |
| 001298.SZ | 好上好  | 2024-08-28 | 减持 | 深圳市研智创业投资合伙企业                                                                                                                                                                                                | 特定股东       | 880,931.00   | 0.43 |
| 301045.SZ | 天禄科技 | 2024-08-27 | 减持 | 马长建                                                                                                                                                                                                          | 持股5%以上股东   | 600,000.00   | 0.54 |
| 688728.SH | 格科微  | 2024-08-27 | 减持 | Pacven Walden Ventures V, L.P., Pacven Walden Ventures Parallel V-A, C.V., Pacven Walden Ventures Parallel V-B, C.V., Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P., Pacven Walden Ventures V-QP Associates | 5%以下股东     | 2,000,000.00 | 0.08 |
| 300951.SZ | 博硕科技 | 2024-08-29 | 减持 | 周丹                                                                                                                                                                                                           | 高级管理人员     | 21,000.00    | 0.01 |
| 300951.SZ | 博硕科技 | 2024-08-29 | 减持 | 杨传奇                                                                                                                                                                                                          | 董事         | 21,000.00    | 0.01 |
| 300951.SZ | 博硕科技 | 2024-08-29 | 减持 | 周丹                                                                                                                                                                                                           | 高级管理人员     | 15,000.00    | 0.01 |
| 300951.SZ | 博硕科技 | 2024-08-29 | 减持 | 杨传奇                                                                                                                                                                                                          | 董事         | 15,000.00    | 0.01 |

数据来源：Wind，华福证券研究所

图表 10：过去一周股权激励一览

| 代码        | 名称   | 公告日期       | 方案进度  | 激励方式                       | 激励总数(万) | 激励总数占当时总股本比例(%) | 期权初始行权价格 |
|-----------|------|------------|-------|----------------------------|---------|-----------------|----------|
| 688020.SH | 方邦股份 | 2024-08-26 | 董事会预案 | 上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股 | 268.00  | 3.3222          | 25.94    |
| 688498.SH | 源杰科技 | 2024-08-30 | 董事会预案 | 上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股 | 57.17   | 0.6690          | 66.06    |
| 688689.SH | 银河微电 | 2024-08-27 | 董事会预案 | 上市公司提取激励基金买入流通股            | 138.80  | 1.0768          | 15.00    |
| 688368.SH | 晶丰明源 | 2024-08-29 | 实施    | 上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股 | 273.13  | 3.1098          | 28.28    |
| 300868.SZ | 杰美特  | 2024-08-30 | 实施    | 上市公司提取激励基金买入流通股            | 199.99  | 1.5624          | 9.50     |

数据来源：Wind，华福证券研究所

四、风险提示

技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险；行业景气不及预期。

## 分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

## 一般声明

华福证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，该等公开资料的准确性及完整性由其发布者负责，本公司及其研究人员对该等信息不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，之后可能会随情况的变化而调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司仅承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告以供投资者参考，但不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。

本报告版权归“华福证券有限责任公司”所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

## 特别声明

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

## 投资评级说明

| 类别   | 评级   | 评级说明                               |
|------|------|------------------------------------|
| 公司评级 | 买入   | 未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在 20%以上       |
|      | 持有   | 未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于 10%与 20%之间 |
|      | 中性   | 未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与 10%之间 |
|      | 回避   | 未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-20%与-10%之间 |
|      | 卖出   | 未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在-20%以下       |
| 行业评级 | 强于大市 | 未来 6 个月内，行业整体回报高于市场基准指数 5%以上       |
|      | 跟随大市 | 未来 6 个月内，行业整体回报介于市场基准指数-5%与 5%之间   |
|      | 弱于大市 | 未来 6 个月内，行业整体回报低于市场基准指数-5%以下       |

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。

## 联系方式

华福证券研究所 上海

公司地址：上海市浦东新区浦明路 1436 号陆家嘴滨江中心 MT 座 20 层

邮编：200120

邮箱：hfyjs@hfzq.com.cn